

# Verbund-Entlötspitze 0.5C Chip - Hakko T8-1003

Artikel-Nr. HK-T8-1003

Hersteller Hakko

EAN 4962615009983

Kein Produktbild

Verbund-Entlötspitze im Format 0.5C Chip, konzipiert für den Einsatz mit der Hakko FM-2022 Parallelpinzette. Ermöglicht das präzise Entfernen kleiner Bauteile. Die Packung enthält 2 Spitzen.

## TECHNISCHE DATEN

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 0.1 kg |
|---------|--------|

|               |       |
|---------------|-------|
| Ursprungsland | Japan |
|---------------|-------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 85159080 |
|-----------------|----------|

## BESCHREIBUNG

## ÜBERSICHT

Die Hakko T8-1003 ist eine Verbund-Entlötspitze im Format 0.5C Chip, die speziell für das Parallelpinzetten-System FM-2022 entwickelt wurde. Diese Präzisionsspitze ermöglicht das effiziente Entfernen kleiner SMD-Bauteile und Chip-Gehäuse von Leiterplatten bei Nacharbeits- und Reparaturarbeiten.

## WESENTLICHE MERKMALE

- Format 0.5C Chip für präzises Ansetzen an Bauteilen
- Verbundkonstruktion für Langlebigkeit und thermische Effizienz
- Kompatibel mit dem Handstück der FM-2022 Parallelpinzette
- Ermöglicht kontrolliertes Entlöten kleiner Bauteile
- 2er-Pack für längeren Einsatz

## ANWENDUNGEN

Ideal für das präzise Entlöten kleiner Chip-Bauteile, SMD-Komponenten und Feinraster-Gehäuse bei Nacharbeits-, Reparatur- und Bauteilaustauscharbeiten an Leiterplatten.

## LIEFERUMFANG

- 2 × Verbund-Entlötspitze Format 0.5C Chip